

2025年3月期 決算説明会

2025年5月20日

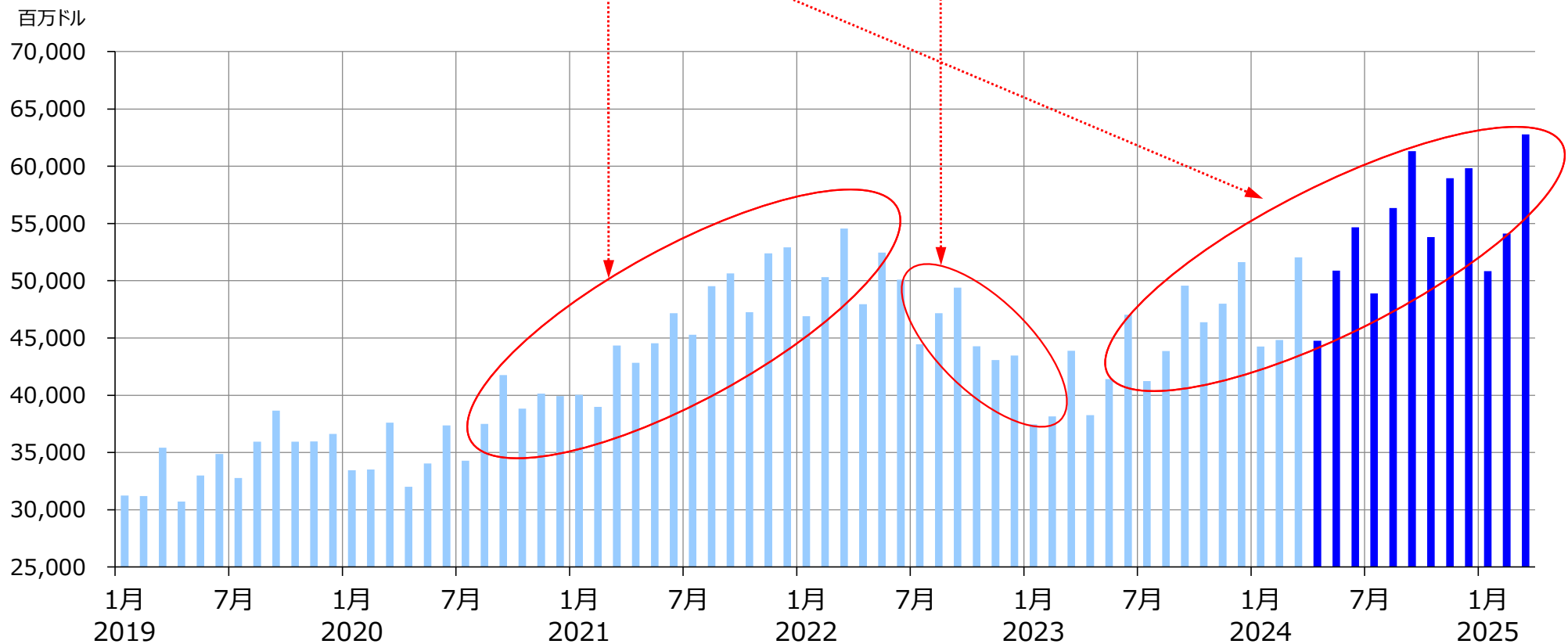
株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

世界半導体市場動向（月次 実績 ※2025年3月まで）

出所：WSTS (2025/5)

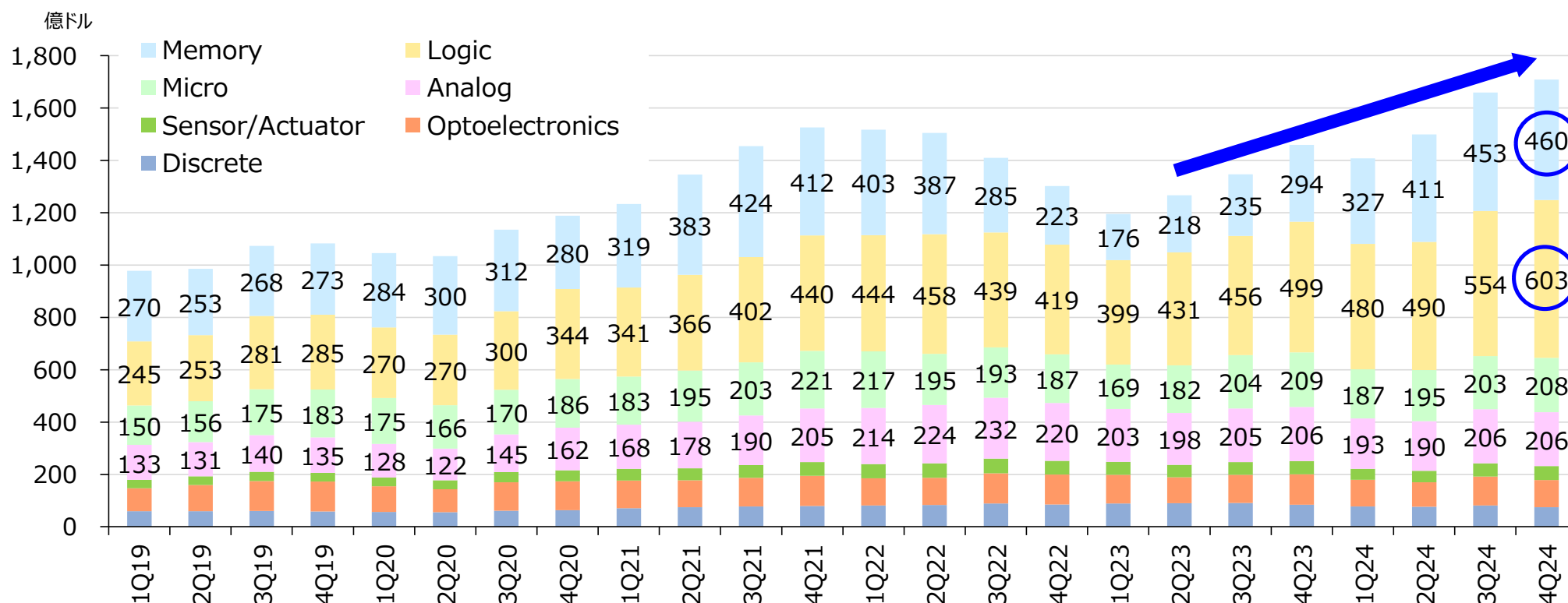
- ・2020年、新型コロナの影響で1月より下降　同年8月以降上昇に転じ、強い半導体需要が2022年6月まで継続
- ・2022年7月以降、生産及び在庫の調整が見られ減速、23年1月には2年半前（20年8月）の水準を割り込むまで下落
- ・その後、AI関連需要を追い風に金額ベースでは回復基調を示しているが、数量ベースの本格的な回復に向かうのか、今後の動向に注視が必要



世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

出所：WSTS

- ・23年2Q（4-6月期）以降は、高価格の生成AI向け半導体が市場を牽引し、拡大が続いている
- ・24年4Q（10-12月期）、市場規模は過去最高を記録：ロジック QoQ +9%, YoY +21%
メモリー QoQ +2%, YoY +56%

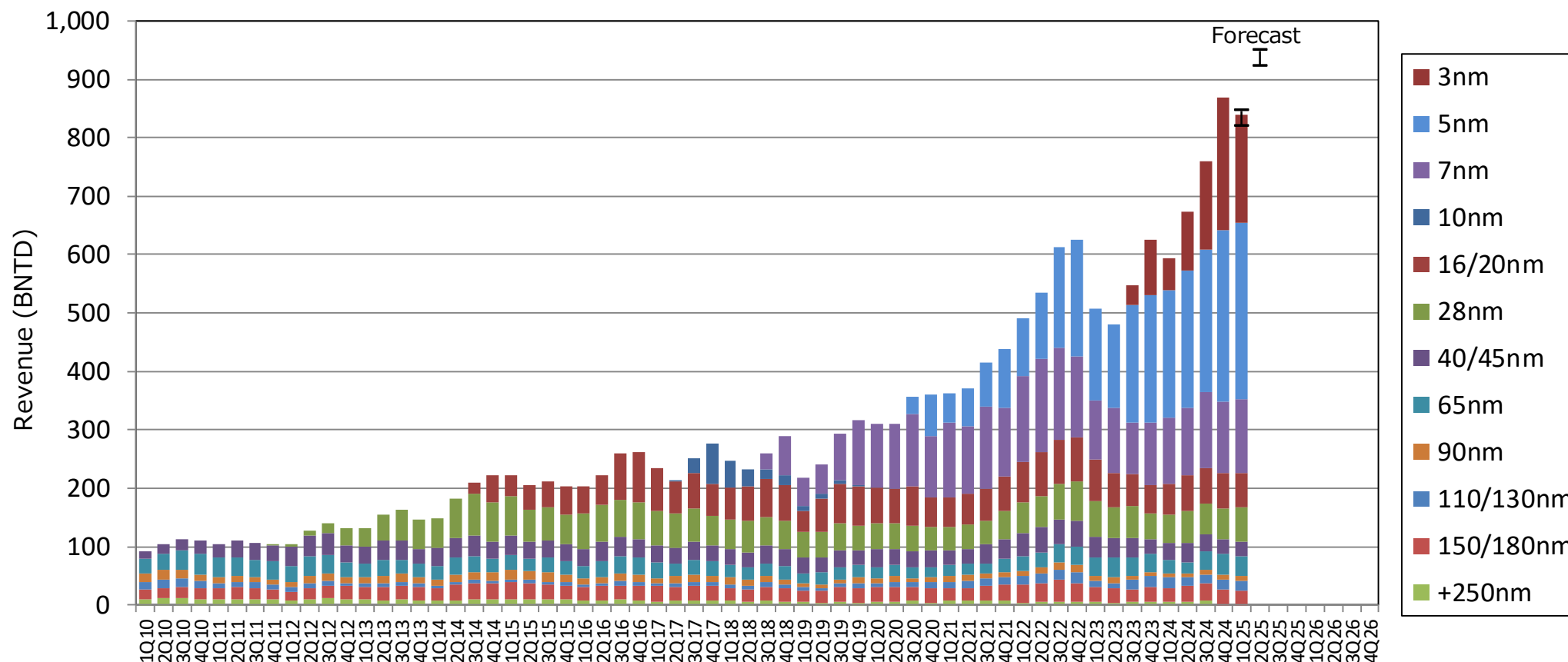


《暦年ベース》

台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2025年1-3月期）

出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

- ・25年1Q（1-3月期）：QoQ -3%, YoY +42%
- ・25年2Q（4-6月期）：ガイダンス QoQ +11% ~ +15%
- ・25年の設備投資計画：380-420億米ドル（24年通期 298億米ドル）

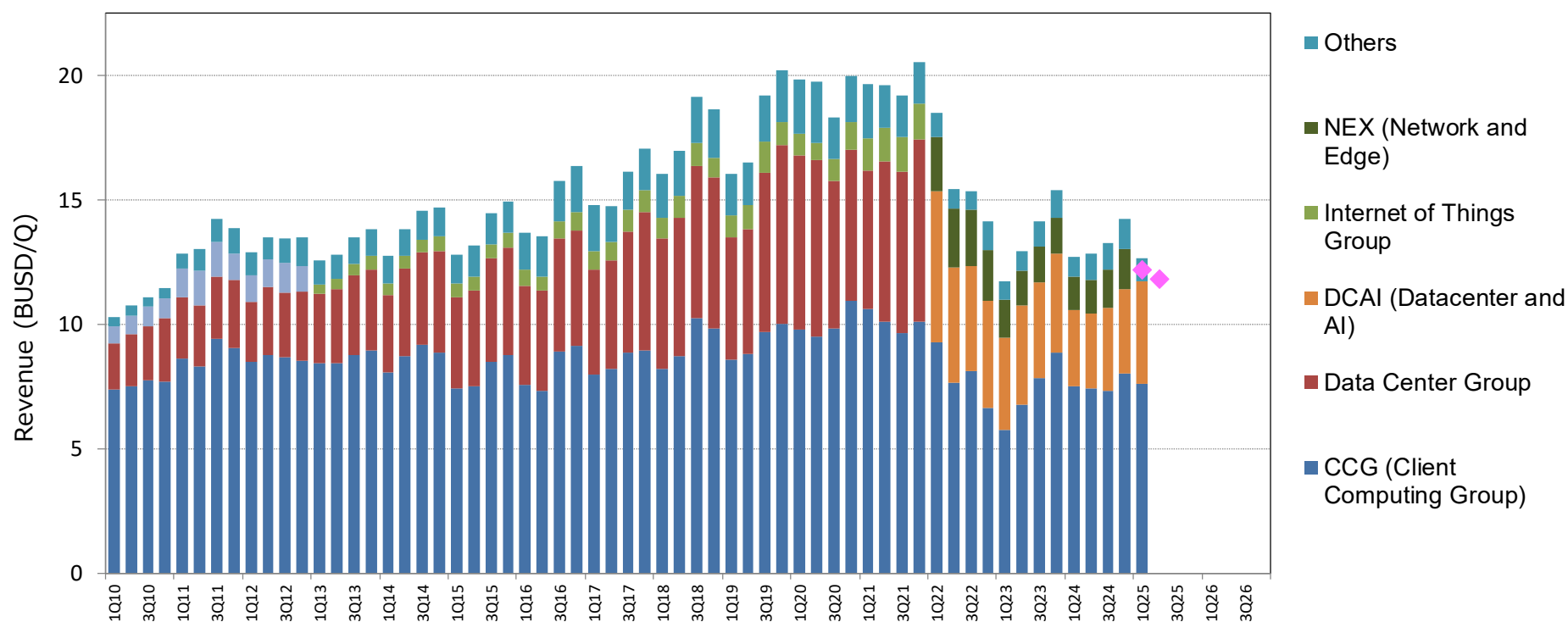


《暦年ベース》

インテル 売上高 (2025年1-3月期)

出所：Intel公開情報よりフジミ作成

- ・25年1Q (1-3月期) : QoQ -11%, YoY -0.4% YoYでは主にPC関連が減少、データセンター・AI関連は増加
- ・25年2Q (4-6月期) : ガイダンス QoQ -12% ~ -2%



《暦年ベース》

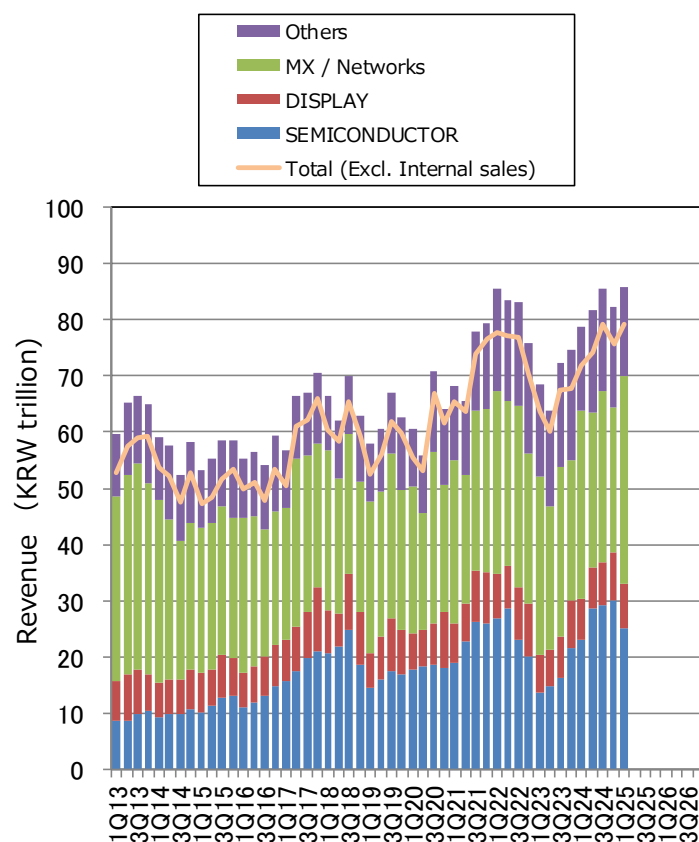
サムスン電子 売上高 (2025年1-3月期)

グラフ出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成
増減コメント出所：サムスン電子公開情報より引用

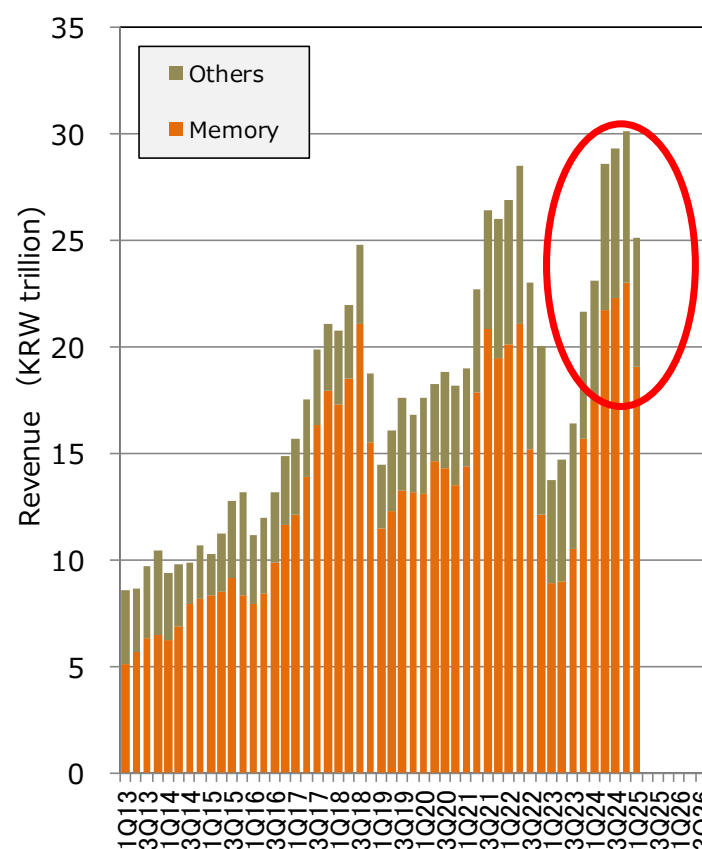
・半導体事業：QoQ -10%, YoY +10%

メモリ：QoQ -17%, YoY +9% HBMの販売減少（AI半導体輸出規制の影響による）及びASPの下落

<サムスン電子 全社 売上高>



<サムスン電子 半導体事業 売上高>

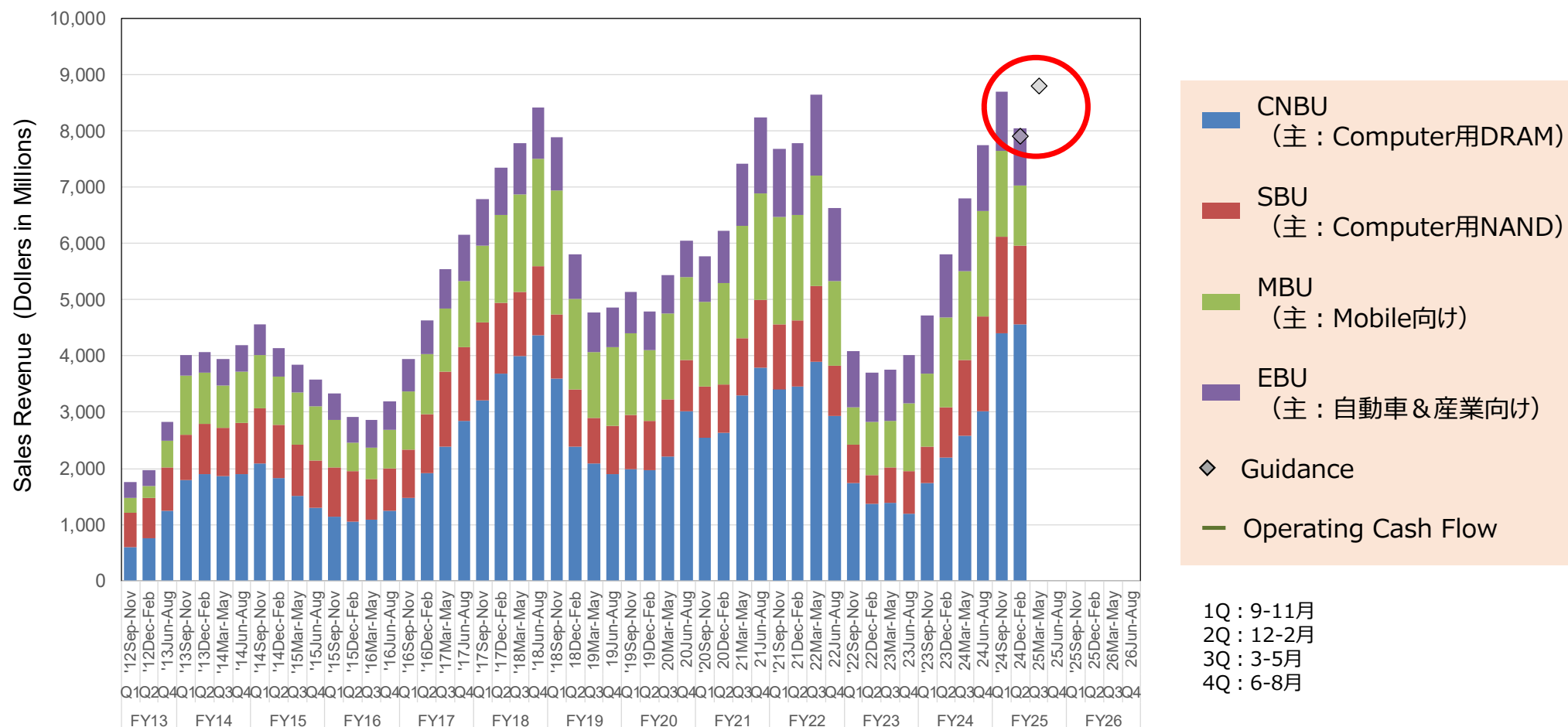


《暦年ベース》

マイクロン・テクノロジー 売上高（2024年12月-2025年2月期）

出所：マイクロン・テクノロジー公開情報よりフジミ作成

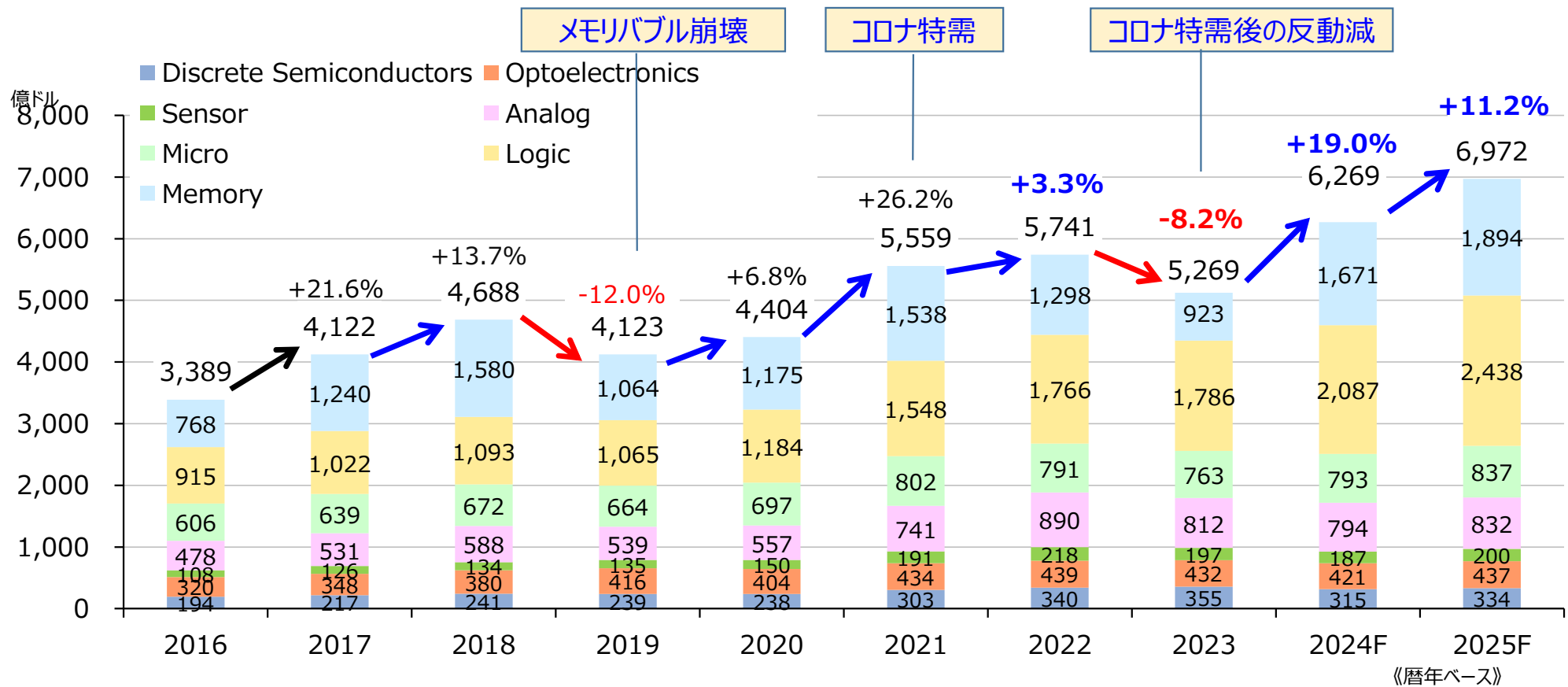
- ・24年12月-25年2月期：QoQ -8% YoY +38% データセンター向けDRAM及びHBM好調、スマートフォン関連減少
- ・25年3月-5月期：ガイダンス QoQ +9%



世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別

出所：WSTS（2024/12/3）

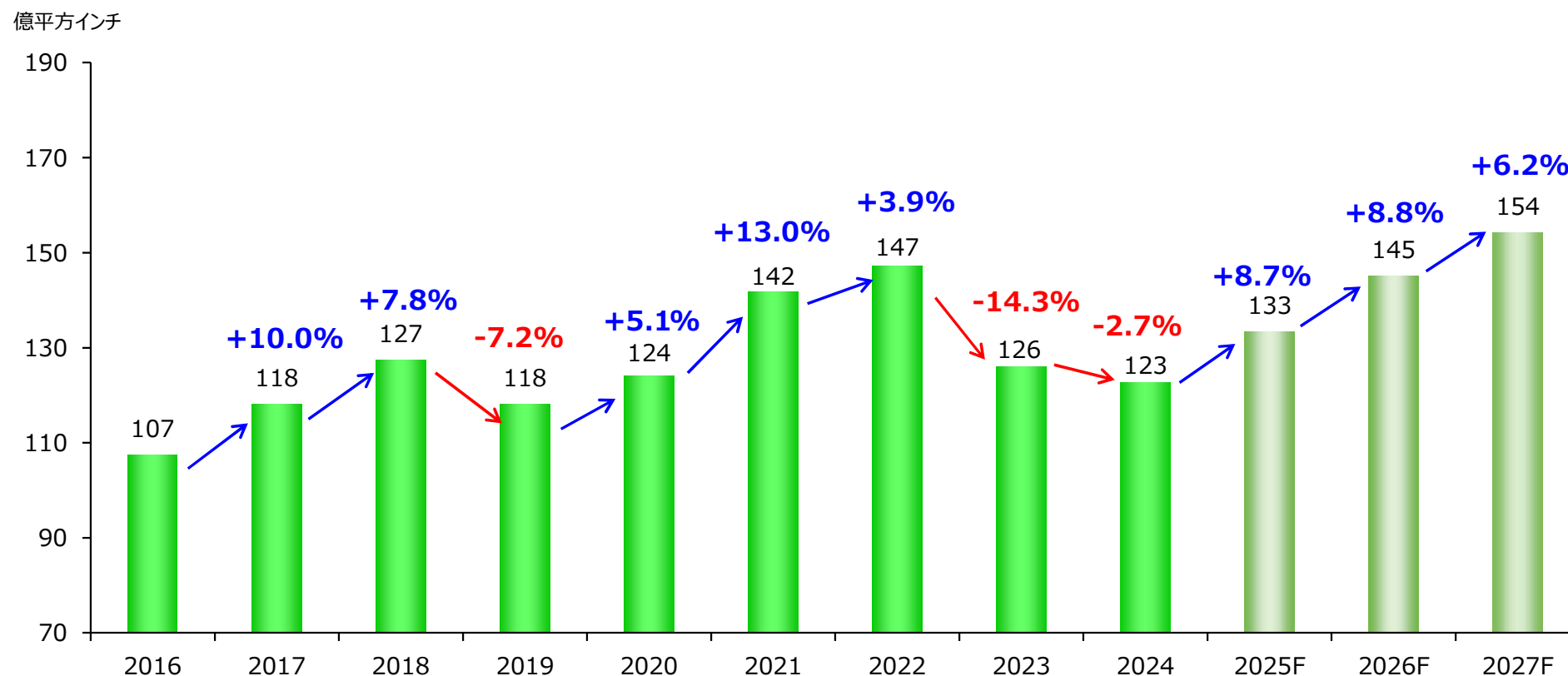
- ・2024年の市場予想：AI関連を除く半導体需要は低調に推移するも、旺盛なAI関連投資を背景に、+19.0%を見込む
- ・2025年の市場予想：高価格の生成AI向け需要が引き続き拡大するとし、+11.2%を見込む



シリコンウェハー需要予測（出荷面積換算 全口径）

出所：SEMI（実績 2025/2/13 予測 2024/10/24）

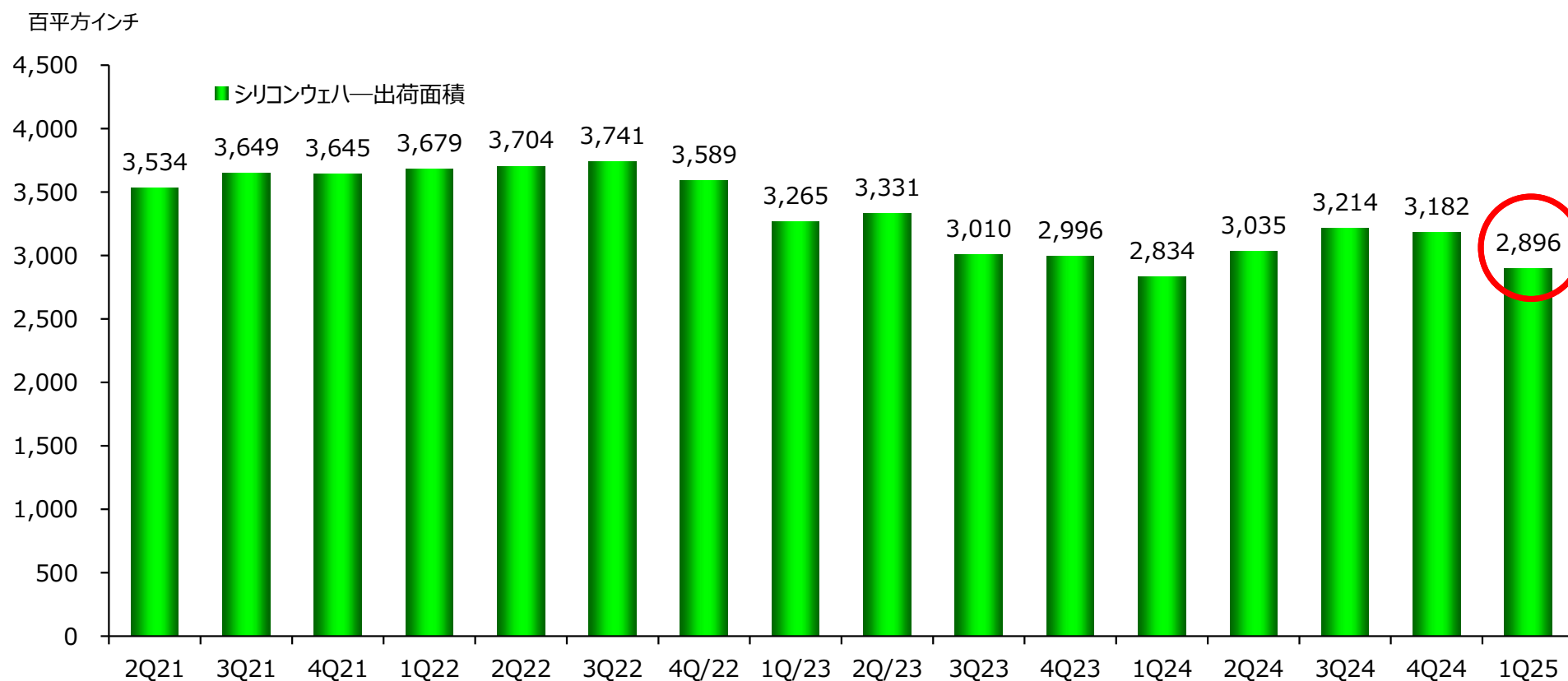
- ・2024年：シリコンウェハー出荷面積は2年連続のマイナス成長 YoY -2.7%
- ・2025年：シリコンウェハー需要はプラスに転じる予測 YoY +8.7%



シリコンウェハー出荷面積 実績（四半期）

出所：SEMI（2025/4/29）

- ・25年1Q：QoQ -10%, YoY+1% 主に季節要因とサプライチェーン全体での在庫の累積が影響
- ・生成AI、データセンター向けの需要は増加するも、PC、スマートフォン向けでは在庫調整が継続



《暦年ベース》

決算概要

決算概要（通期実績）

* 1 当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益 * 2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

	24年3月期	25年3月期					
	通期実績	期初予想 ('24/5)	修正予想 ('24/9)	通期実績	前期比	期初予想比 ('24/5)	修正予想比 ('24/9)
売上高	51,423	54,700	61,100	62,503	+21.5%	+14.3%	+2.3%
営業利益	8,251	8,500	10,650	11,780	+42.8%	+38.6%	+10.6%
率	16.0%	15.5%	17.4%	18.8%	-	-	-
経常利益	8,958	8,700	11,150	12,251	+36.8%	+40.8%	+9.9%
率	17.4%	15.9%	18.2%	19.6%	-	-	-
当期純利益 ^{*1}	6,499	6,500	8,350	9,428	+45.1%	+45.1%	+12.9%
率	12.6%	11.9%	13.7%	15.1%	-	-	-
EBITDA ^{*2}	10,305	10,600	12,650	13,783	+33.7%	+30.0%	+8.8%
率	20.0%	19.4%	20.7%	22.1%	-	-	-

- ・売上高：過去最高を更新
- ・先端半導体向けCMP製品及びシリコンウェハー向け製品の販売が好調に推移し、増収増益
- ・営業利益率：18.8%（前期比2.8ポイント上昇）
- ・EBITDAマージン：22.1%（前期比2.1ポイント上昇）
- ・為替実績：152円／ドル（24年3月期：144円／ドル）

決算概要（半期実績）

* 1 純利益：親会社株主に帰属する純利益 * 2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

	24年3月期		25年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
売上高	25,352	26,070	30,746	+21.3%	+17.9%	31,757	+21.8%	+3.3%
営業利益	3,949	4,302	5,702	+44.4%	+32.5%	6,077	+41.3%	+6.6%
率	15.6%	16.5%	18.5%	-	-	19.1%	-	-
経常利益	4,430	4,527	5,620	+26.9%	+24.1%	6,631	+46.5%	+18.0%
率	17.5%	17.4%	18.3%	-	-	20.9%	-	-
純利益 ^{*1}	3,377	3,121	4,370	+29.4%	+40.0%	5,058	+62.1%	+15.8%
率	13.3%	12.0%	14.2%	-	-	15.9%	-	-
EBITDA ^{*2}	4,912	5,391	6,645	+35.3%	+23.2%	7,138	+32.4%	+7.4%
率	19.4%	20.7%	21.6%	-	-	22.5%	-	-

・下期は上期同様、先端半導体向けCMP製品及びシリコンウェハ向け製品の販売が好調に推移し、増収増益
 但し、足元、メモリデバイスメーカー生産調整、シリコンウェハメーカーにおいても出荷足踏み
 （ウェハ販売（面積ベース）はCY25 1Q減少）

業績予想（通期）

* 1 当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益 * 2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

	24年3月期	25年3月期	26年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想	前期比
売上高	51,423	62,503	65,300	+4.5%
営業利益	8,251	11,780	12,100	+2.7%
率	16.0%	18.8%	18.5%	-
経常利益	8,958	12,251	12,100	△1.2%
率	17.4%	19.6%	18.5%	-
当期純利益 ^{*1}	6,499	9,428	8,850	△6.1%
率	12.6%	15.1%	13.6%	-
EBITDA ^{*2}	10,305	13,783	14,800	+7.4%
率	20.0%	22.1%	22.7%	-

- ・増収、営業増益予想
- ・想定為替レート：140円／ドル（前年実績：152円／ドル）
- ・売上高：半導体業界の本格的な回復には依然時間を要すものの緩やかな回復を想定
- ・営業利益：売上高4.5%増に対し、営業利益2.7%増（設備投資関連人員増及び償却開始等先行的な費用増）
- ・経常利益：営業外損益±0（配当収入・金利収入等あるも、工場建設のための資金調達関連費用を見込む）
- ・当期純利益：前期は賃上促進税制による税控除あり
- ・EBITDAマージン：営業利益率は0.3ポイント減となるも償却増のため、EBITDAマージンは上昇

業績予想（半期）

* 1 純利益：親会社株主に帰属する純利益 * 2 EBITDA=営業利益+減価償却費

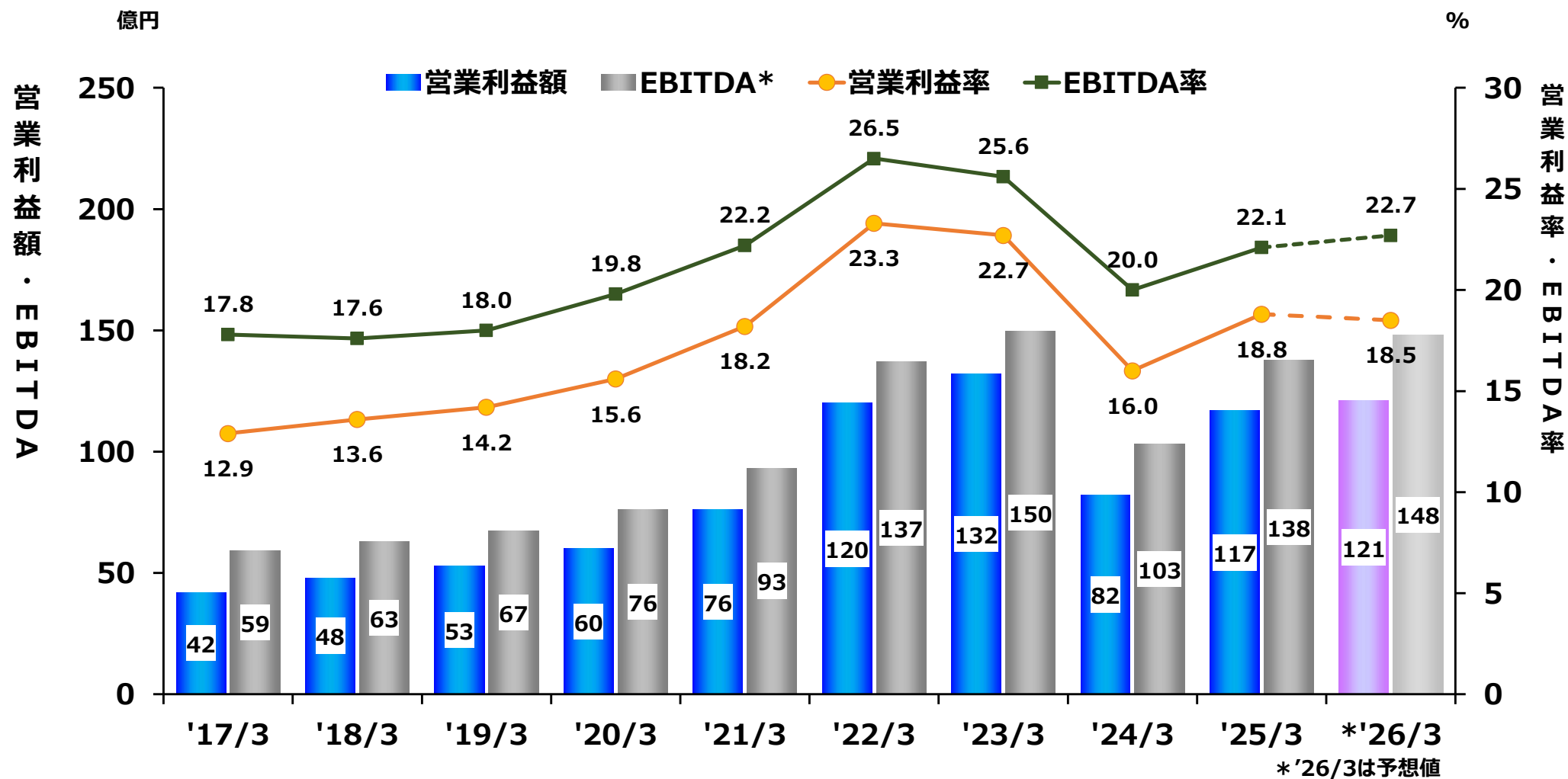
単位：百万円

	25年3月期		26年3月期					
	上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
売上高	30,746	31,757	31,800	+3.4%	+0.1%	33,500	+5.5%	+5.3%
営業利益	5,702	6,077	5,950	+4.3%	△2.1%	6,150	+1.2%	+3.4%
率	18.5%	19.1%	18.7%	-	-	18.4%	-	-
経常利益	5,620	6,631	6,000	+6.8%	△9.5%	6,100	△8.0%	+1.7%
率	18.3%	20.9%	18.9%	-	-	18.2%	-	-
純利益 ^{*1}	4,370	5,058	4,400	+0.7%	△13.0%	4,450	△12.0%	+1.1%
率	14.2%	15.9%	13.8%	-	-	13.3%	-	-
EBITDA ^{*2}	6,645	7,138	7,050	+6.1%	△1.2%	7,750	+8.6%	+9.9%
率	21.6%	22.5%	22.2%	-	-	23.1%	-	-

・下期には、半導体の緩やかな回復に伴い、売上増加を想定（本格的な回復は2026年以降と想定）

営業利益、EBITDA（今期予想含む）

* EBITDA=営業利益+減価償却費



用途別売上高

用途別売上高（通期実績）

単位：百万円

		24年3月期	25年3月期					
		通期実績	期初予想 ('24/5)	修正予想 ('24/11)	通期実績	前期比	期初予想比 ('24/5)	修正予想比 ('24/11)
シリコンウェハ	ラッピング	5,474	5,650	7,500	7,563	+38.2%	+33.9%	+0.9%
	ポリシング	9,909	10,950	12,150	12,698	+28.1%	+16.0%	+4.5%
	切断	186	100	150	175	△5.8%	+76.0%	+17.3%
	計	15,570	16,700	19,800	20,437	+31.3%	+22.4%	+3.2%
CMP		27,401	28,900	29,900	30,658	+11.9%	+6.1%	+2.5%
ディスク		1,383	1,500	2,600	2,547	+84.1%	+69.8%	△2.0%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,479	4,900	5,300	5,415	+20.9%	+10.5%	+2.2%
	一般工業用(非研磨材)	2,480	2,600	3,400	3,314	+33.6%	+27.5%	△2.5%
	計	6,959	7,500	8,700	8,729	+25.4%	+16.4%	+0.3%
製品売上高		51,314	54,600	61,000	62,373	+21.5%	+14.2%	+2.3%
商品売上高		108	100	100	129	+20.2%	+29.9%	+29.9%
売上高 合計		51,423	54,700	61,100	62,503	+21.5%	+14.3%	+2.3%

用途別売上高（半期実績）

単位：百万円

単位：百万円		24年3月期		25年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
シリコンウェハ	ラッピング	2,818	2,655	3,791	+34.5%	+42.8%	3,772	+42.1%	△0.5%
	ポリシング	5,487	4,422	6,123	+11.6%	+38.5%	6,574	+48.7%	+7.4%
	切断	98	88	81	△17.6%	△8.0%	94	+7.3%	+16.6%
	計	8,404	7,165	9,996	+18.9%	+39.5%	10,441	+45.7%	+4.5%
CMP		12,962	14,439	15,033	+16.0%	+4.1%	15,625	+8.2%	+3.9%
ディスク		470	913	1,290	+174.2%	+41.3%	1,256	+37.6%	△2.6%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,229	2,249	2,639	+18.4%	+17.3%	2,775	+23.4%	+5.2%
	一般工業用(非研磨材)	1,251	1,228	1,708	+36.6%	+39.0%	1,605	+30.7%	△6.0%
	計	3,480	3,478	4,348	+24.9%	+25.0%	4,381	+25.9%	+0.8%
製品売上高		25,318	25,996	30,668	+21.1%	+18.0%	31,705	+22.0%	+3.4%
商品売上高		34	73	78	+124.8%	+6.3%	51	△29.3%	△33.5%
売上高 合計		25,352	26,070	30,746	+21.3%	+17.9%	31,757	+21.8%	+3.3%

用途別売上高（通期予想）

単位：百万円

		24年3月期	25年3月期	26年3月期	
		通期実績	通期実績	通期予想	前期比
シリコンウェハ	ラッピング	5,474	7,563	7,650	+1.1%
	ポリシング	9,909	12,698	13,250	+4.3%
	切断	186	175	200	+13.7%
	計	15,570	20,437	21,100	+3.2%
CMP		27,401	30,658	31,600	+3.1%
ディスク		1,383	2,547	2,550	+0.1%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,479	5,415	6,600	+21.9%
	一般工業用(非研磨材)	2,480	3,314	3,350	+1.1%
	計	6,959	8,729	9,950	+14.0%
製品売上高		51,314	62,373	65,200	+4.5%
商品売上高		108	129	100	△23.0%
売上高 合計		51,423	62,503	65,300	+4.5%

用途別売上高（半期予想）

単位：百万円

		25年3月期		26年3月期					
		上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
シリコンウェハ	ラッピング	3,791	3,772	3,750	△1.1%	△0.6%	3,900	+3.4%	+4.0%
	ポリシング	6,123	6,574	6,550	+7.0%	△0.4%	6,700	+1.9%	+2.3%
	切断	81	94	100	+23.1%	+5.6%	100	+5.6%	±0.0%
	計	9,996	10,441	10,400	+4.0%	△0.4%	10,700	+2.5%	+2.9%
CMP		15,033	15,625	15,600	+3.8%	△0.2%	16,000	+2.4%	+2.6%
ディスク		1,290	1,256	1,200	△7.0%	△4.5%	1,350	+7.4%	+12.5%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,639	2,775	3,000	+13.7%	+8.1%	3,600	+29.7%	+20.0%
	一般工業用(非研磨材)	1,708	1,605	1,550	△9.3%	△3.5%	1,800	+12.1%	+16.1%
	計	4,348	4,381	4,550	+4.6%	+3.8%	5,400	+23.2%	+18.7%
製品売上高		30,668	31,705	31,750	+3.5%	+0.1%	33,450	+5.5%	+5.4%
商品売上高		78	51	50	△35.9%	△3.7%	50	△3.7%	±0.0%
売上高 合計		30,746	31,757	31,800	+3.4%	+0.1%	33,500	+5.5%	+5.3%

シリコンウェハー売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

「通期」

単位：百万円

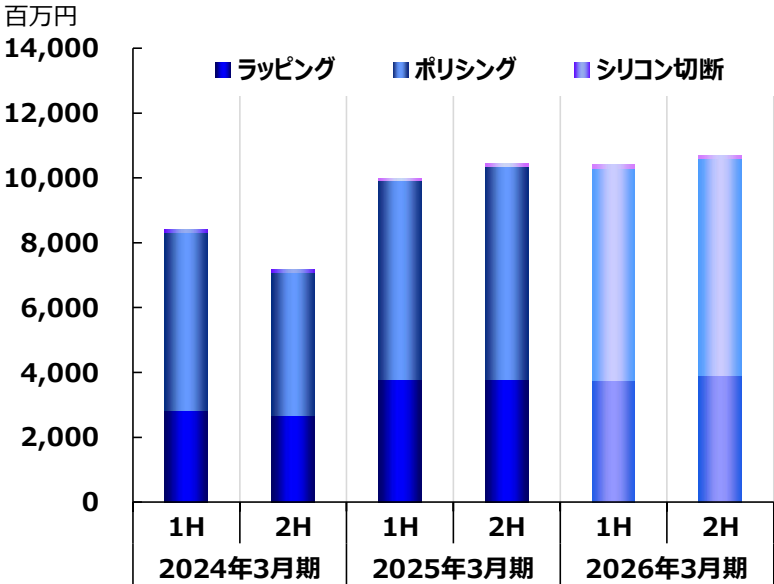
		24年3月期	25年3月期		26年3月期	
		通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
シリコンウェハー	ラッピング	5,474	7,563	+38.2%	7,650	+1.1%
	ポリシング	9,909	12,698	+28.1%	13,250	+4.3%
	切断	186	175	△5.8%	200	+13.7%
	計	15,570	20,437	+31.3%	21,100	+3.2%

「半期」

単位：百万円

		24年3月期		25年3月期		26年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
シリコンウェハー	ラッピング	2,818	2,655	3,791	3,772	3,750	3,900
	ポリシング	5,487	4,422	6,123	6,574	6,550	6,700
	切断	98	88	81	94	100	100
	計	8,404	7,165	9,996	10,441	10,400	10,700

（25/3）シリコンウェハー生産回復に伴い増収（但し、ウェハー販売はCY25 1Q減少）
（26/3）下期には、半導体業界の緩やかな回復に伴い、ウェハー生産の回復を想定



* '26/3は予想値

CMP売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

＜＜通期＞＞

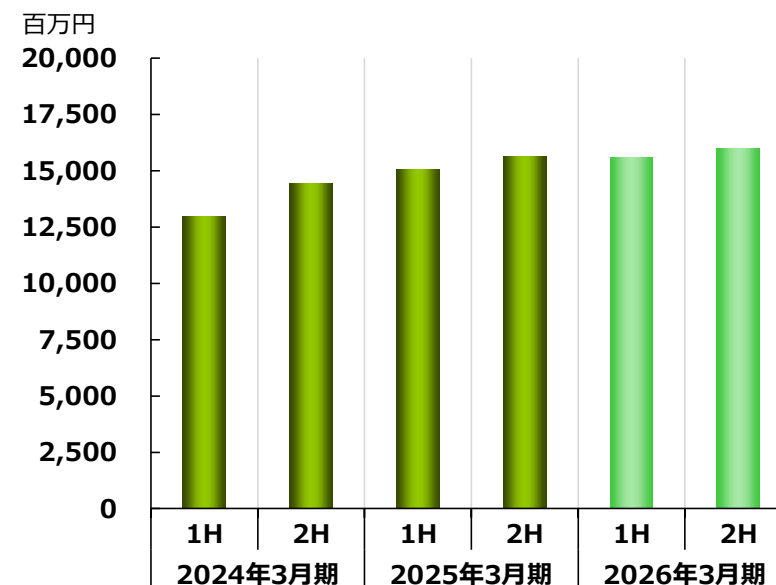
単位：百万円

	24年3月期	25年3月期		26年3月期	
	通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
CMP	27,401	30,658	+11.9%	31,600	+3.1%

＜＜半期＞＞

単位：百万円

	24年3月期		25年3月期		26年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
CMP	12,962	14,439	15,033	15,625	15,600	16,000



（25/3）先端ロジックデバイスやメモリ向けで増収

（26/3）半導体業界の緩やかな回復に伴い、下期には顧客稼働の回復を想定

* '26/3は予想値

ディスク売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

「通期」

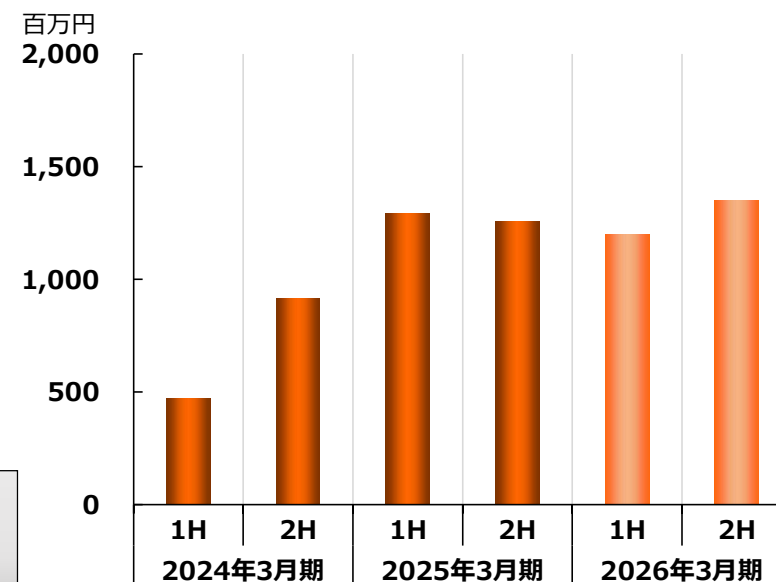
単位：百万円

	24年3月期	25年3月期		26年3月期	
	通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
ディスク	1,383	2,547	+84.1%	2,550	+0.1%

「半期」

単位：百万円

	24年3月期		25年3月期		26年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
ディスク	470	913	1,290	1,256	1,200	1,350



（25/3）データセンター向けHDDの需要増加を受け増収
（26/3）HDDの需要は引き続き高水準で推移すると想定し、前期並みを予想

*'26/3は予想値

機能材・溶射材売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

「通期」

単位：百万円

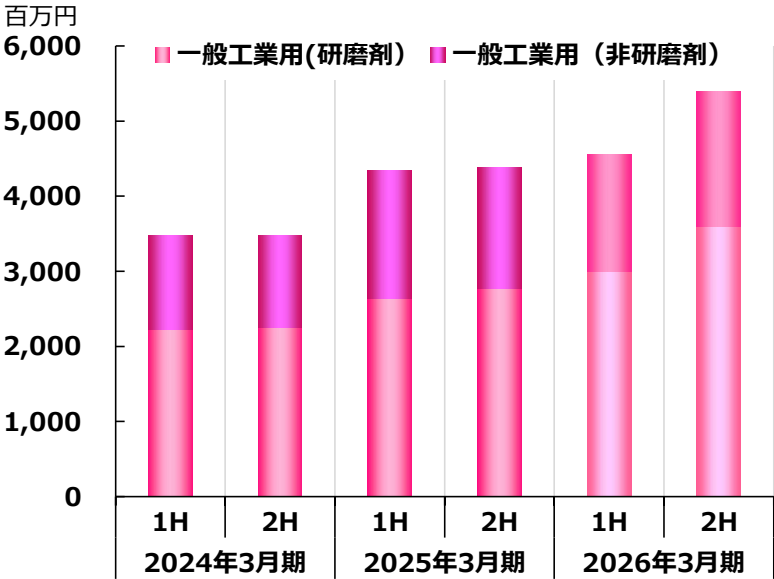
		24年3月期	25年3月期		26年3月期	
		通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	4,479	5,415	+20.9%	6,600	+21.9%
	一般工業用（非研磨材）	2,480	3,314	+33.6%	3,350	+1.1%
	計	6,959	8,729	+25.4%	9,950	+14.0%

「半期」

単位：百万円

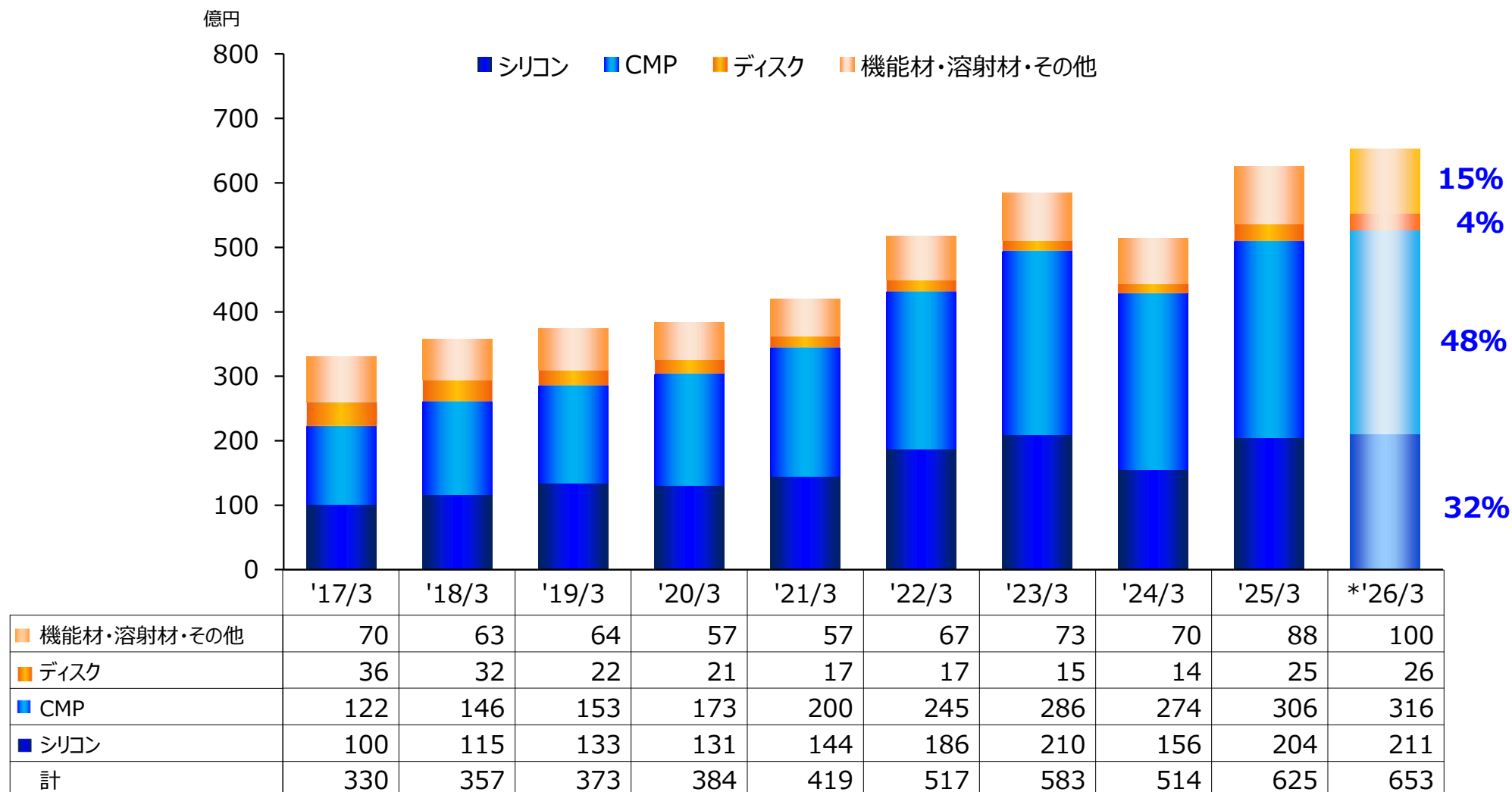
		24年3月期		25年3月期		26年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	2,229	2,249	2,639	2,775	3,000	3,600
	一般工業用（非研磨材）	1,251	1,228	1,708	1,605	1,550	1,800
	計	3,480	3,478	4,348	4,381	4,550	5,400

【研磨材】（25/3）自動車及び産業機械向けで増収
（26/3）南興セラミックスの子会社化に伴い増収を予想
【〃 以外】（25/3）半導体製造装置向け溶射材で増収
（26/3）前期並みを予想（半導体製造装置向けは下期の回復を想定）

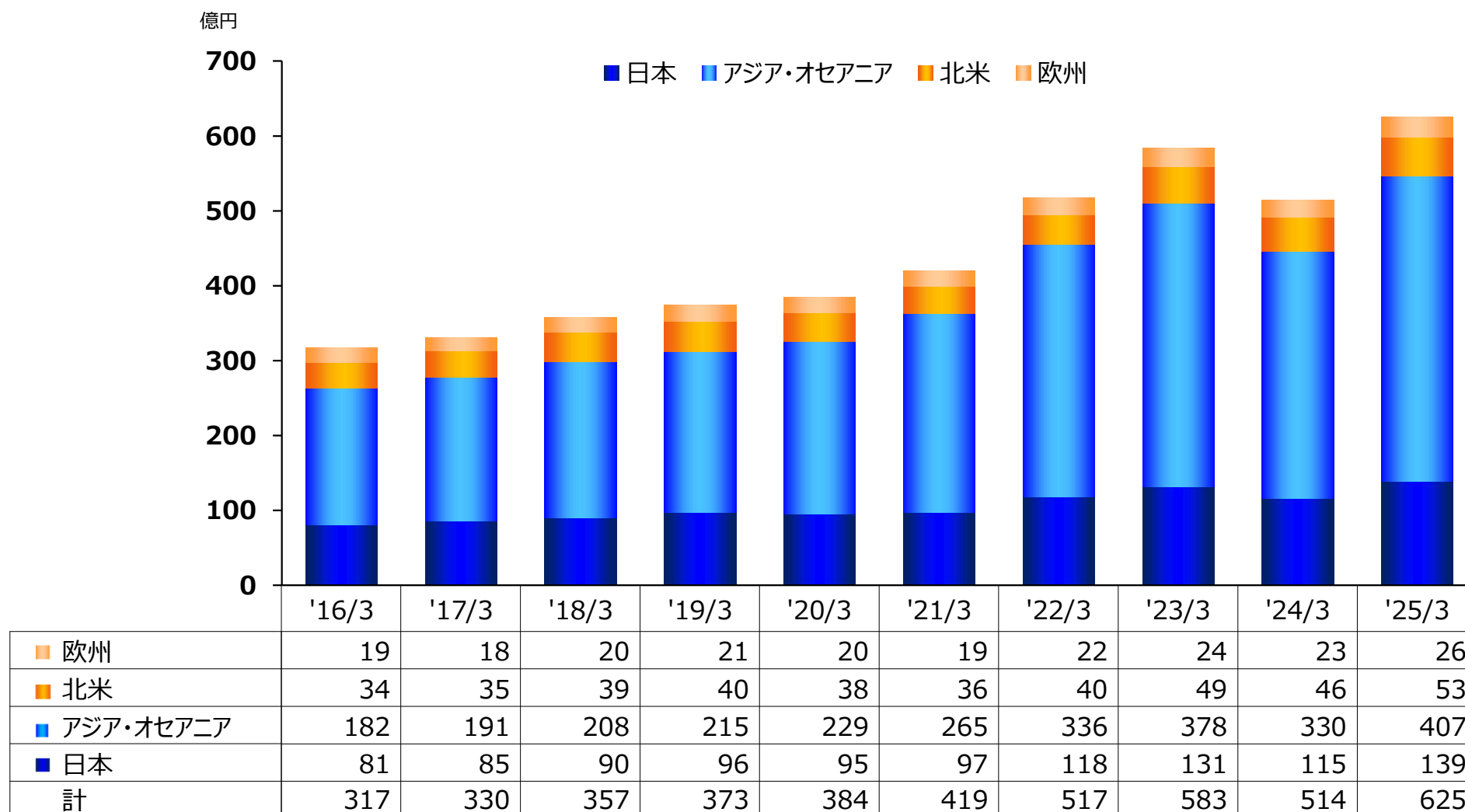


* '26/3は予想値

用途別売上高（通期）



地域別売上高（通期 仕向先別）



**設備投資額
減価償却費
研究開発費**

中期的な設備投資計画

2022年6月 2022年3月期決算説明会資料再掲

- ・ 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- ・ 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

各務山新工場建設（計画）

敷地面積：28千㎡

’21年12月に売買契約を締結

- ・ シリコン、CMP製品の生産能力増強

FUJIMI CORPORATION（米国）

既存工場敷地内に新棟建設を計画

- ・ CMP生産スペース拡大

FUJIMI TAIWAN（台湾）

- ・ 建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画

- ・ 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター（仮称）建設（計画）

敷地面積：16千㎡

現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済

- ・ 非半導体関連の研究施設を設置



中期的な設備投資計画（アップデート）

2024年11月 2025年3月期第2四半期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ '21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	'24年10月 着工 '25年末 竣工 '26年中 試作品出荷 '27年中 本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品	新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） '25年末 設備設置完了	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画	'25年末 導入完了 '26年 生産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を当下期に開始予定
・中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資		
第2開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 ・非半導体関連の研究施設を設置	'25年5月着工に向けて予定通り進捗（詳細設計中）	

中期的な設備投資計画（アップデート）

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ ’21年12月に売買契約を締結 シリコン、CMP製品生産能力増強	’24年10月 着工 ’25年末 竣工 ’26年中 試作品出荷 ’27年中 本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 - CMP製品生産スペース拡大 - SiC用製品	新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） ’25年末 設備設置完了	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） 建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画	’25年末 導入完了 ’26年 生産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を開始

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 非半導体関連の研究施設を設置	’25年5月 着工 ’26年10月 竣工 完成予想図→	
---	--	---

中期的な設備投資計画（各務山新工場アップデート）

各務山新工場 完成予想図



Copyright(c) 2025 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

✓ 25年末の竣工に向けて建設工事は予定通り進捗

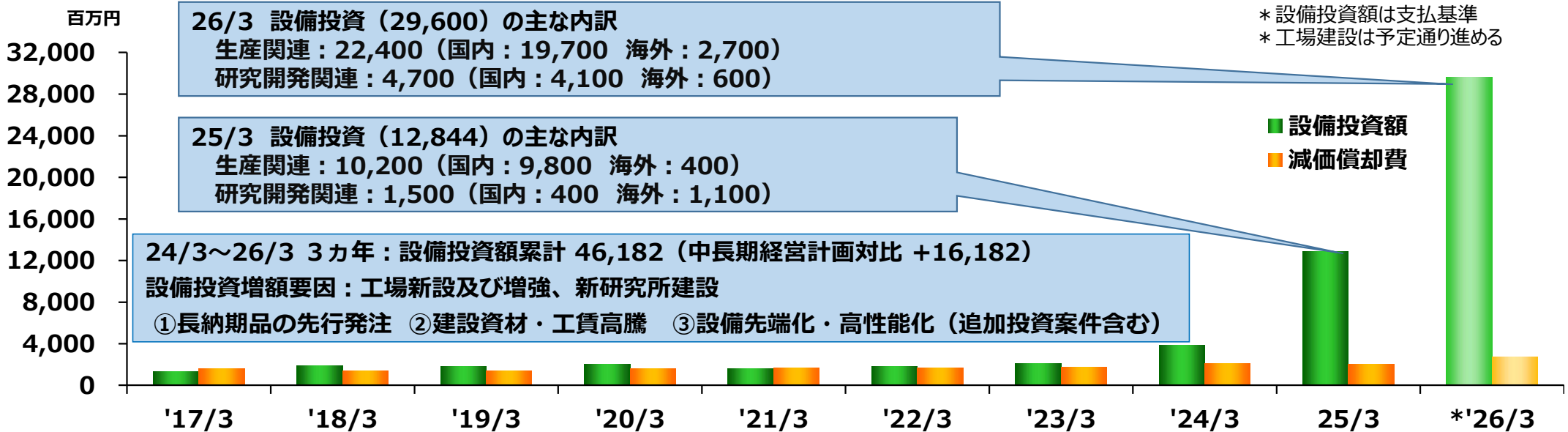
新工場工事写真（5月13日撮影）



設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	24年3月期	25年3月期						26年3月期	
	通期実績	期初計画	修正計画	通期実績	前期比	期初計画比	修正計画比	通期計画	前期比
設備投資額	3,738	12,700	14,870	12,844	+243.6%	+1.1%	△13.6%	29,600	+130.5%
減価償却費	2,053	2,100	2,000	2,003	△2.4%	△4.6%	+0.2%	2,700	+34.8%

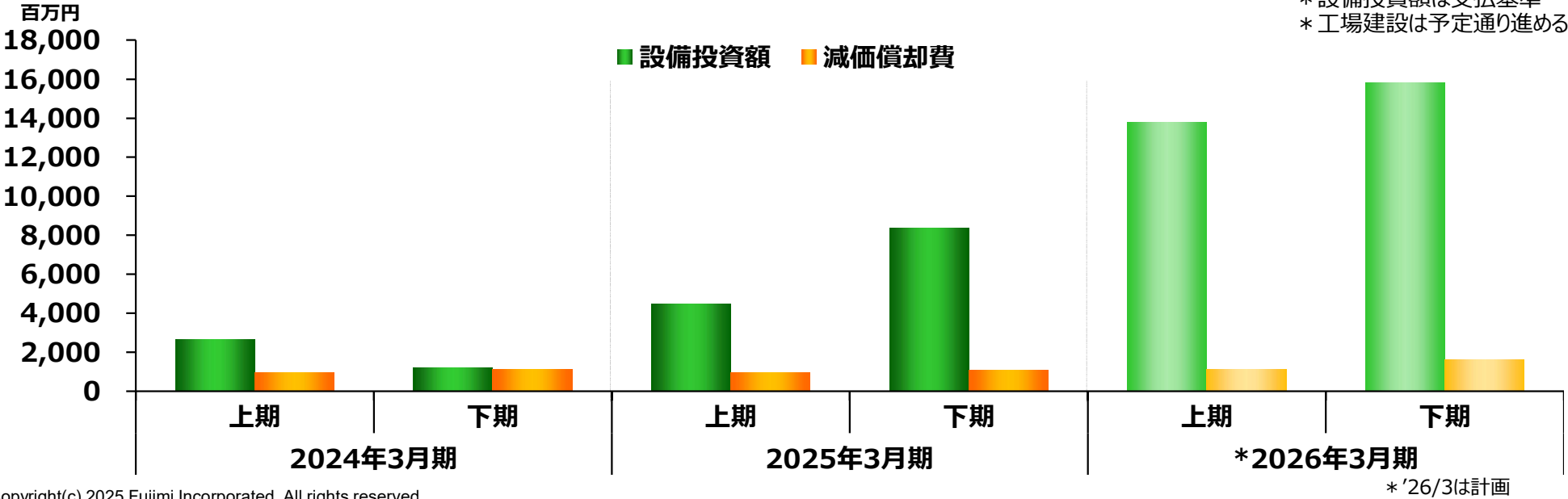


* 設備投資額は支払基準
 * 工場建設は予定通り進める

設備投資額・減価償却費（半期実績・半期計画）

単位：百万円

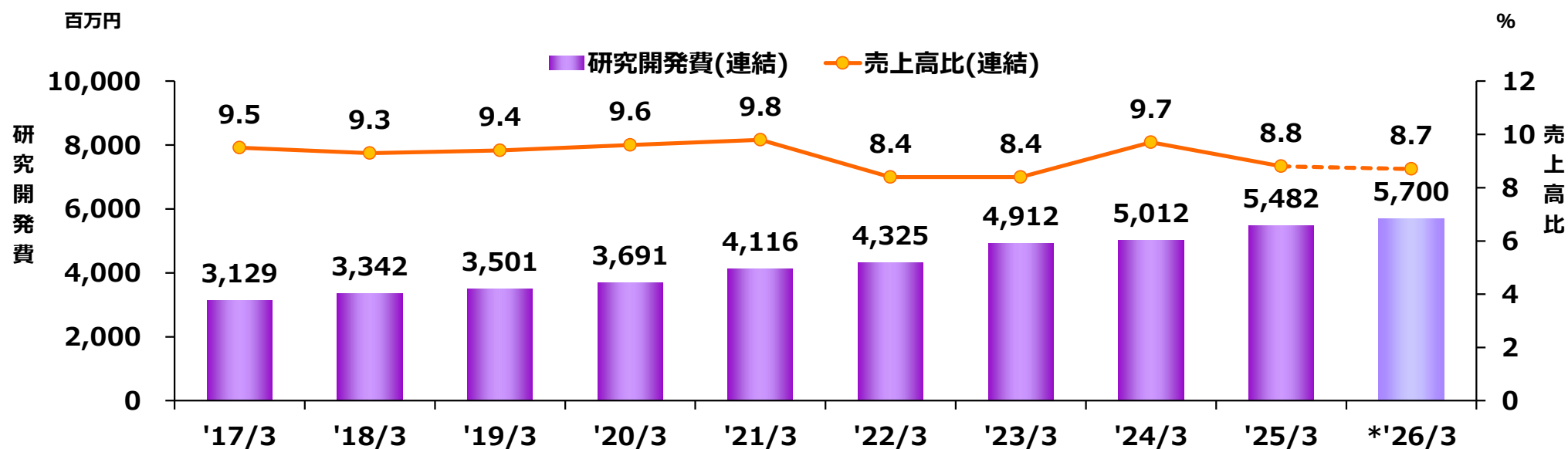
	24年3月期		25年3月期				26年3月期					
	上期 実績	下期 実績	上期 実績	下期 実績	前年 同期比	同年 上期比	上期 計画	前年 同期比	前年 下期比	下期 計画	前年 同期比	同年 上期比
設備投資額	2,243	1,495	4,473	8,371	+459.9%	+87.1%	13,800	+208.5%	+64.9%	15,800	+88.7%	+14.5%
減価償却費	963	1,090	942	1,061	△2.7%	+12.6%	1,100	+16.8%	+3.7%	1,600	+50.8%	+45.5%



研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

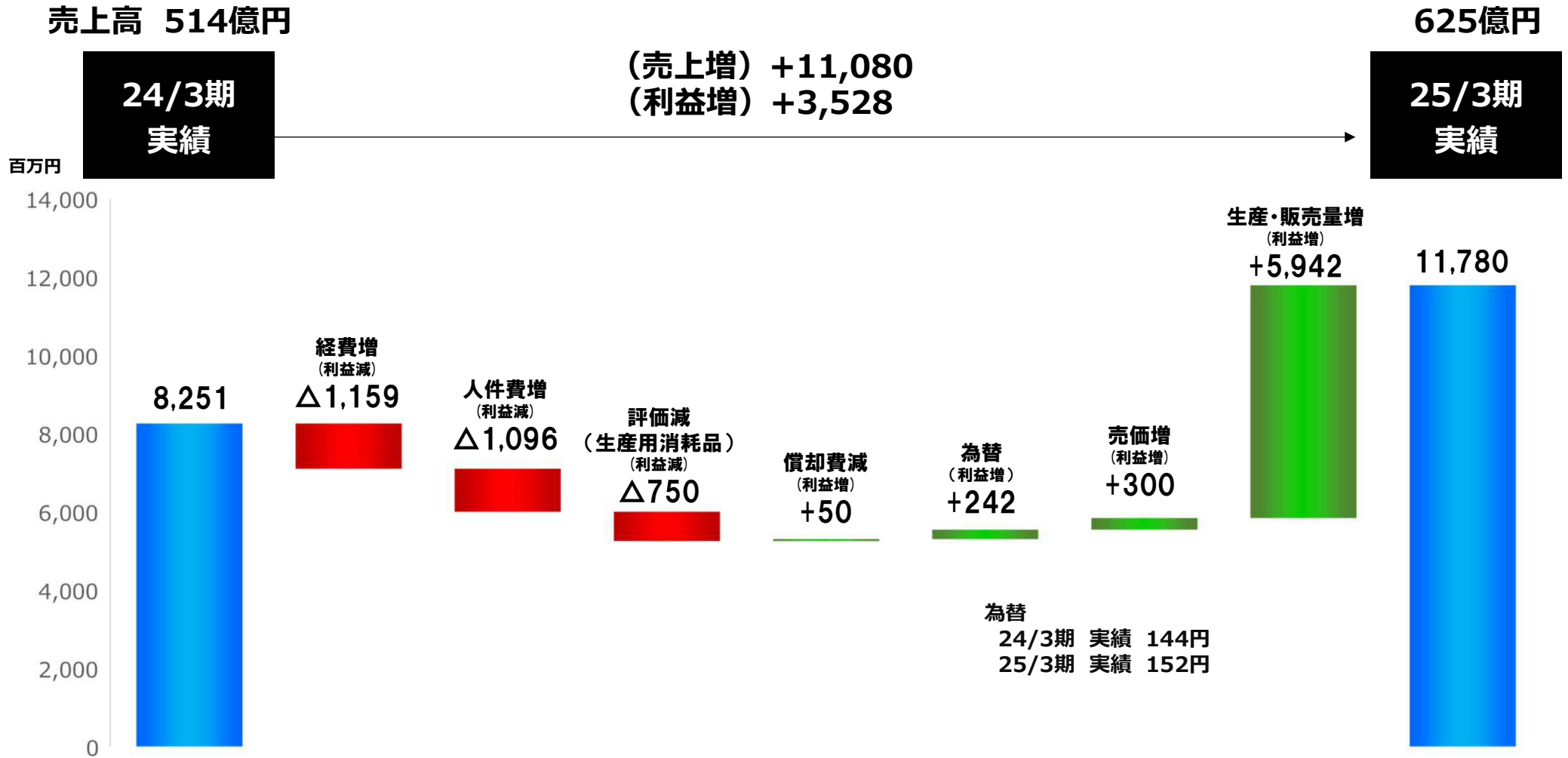
単位：百万円

	24年3月期	25年3月期						26年3月期	
	通期実績	通期計画	修正計画	通期実績	前期比	期初計画比	修正計画比	通期計画	前期比
研究開発費	5,012	5,200	5,400	5,482	+9.4%	+5.4%	+1.5%	5,700	+4.0%

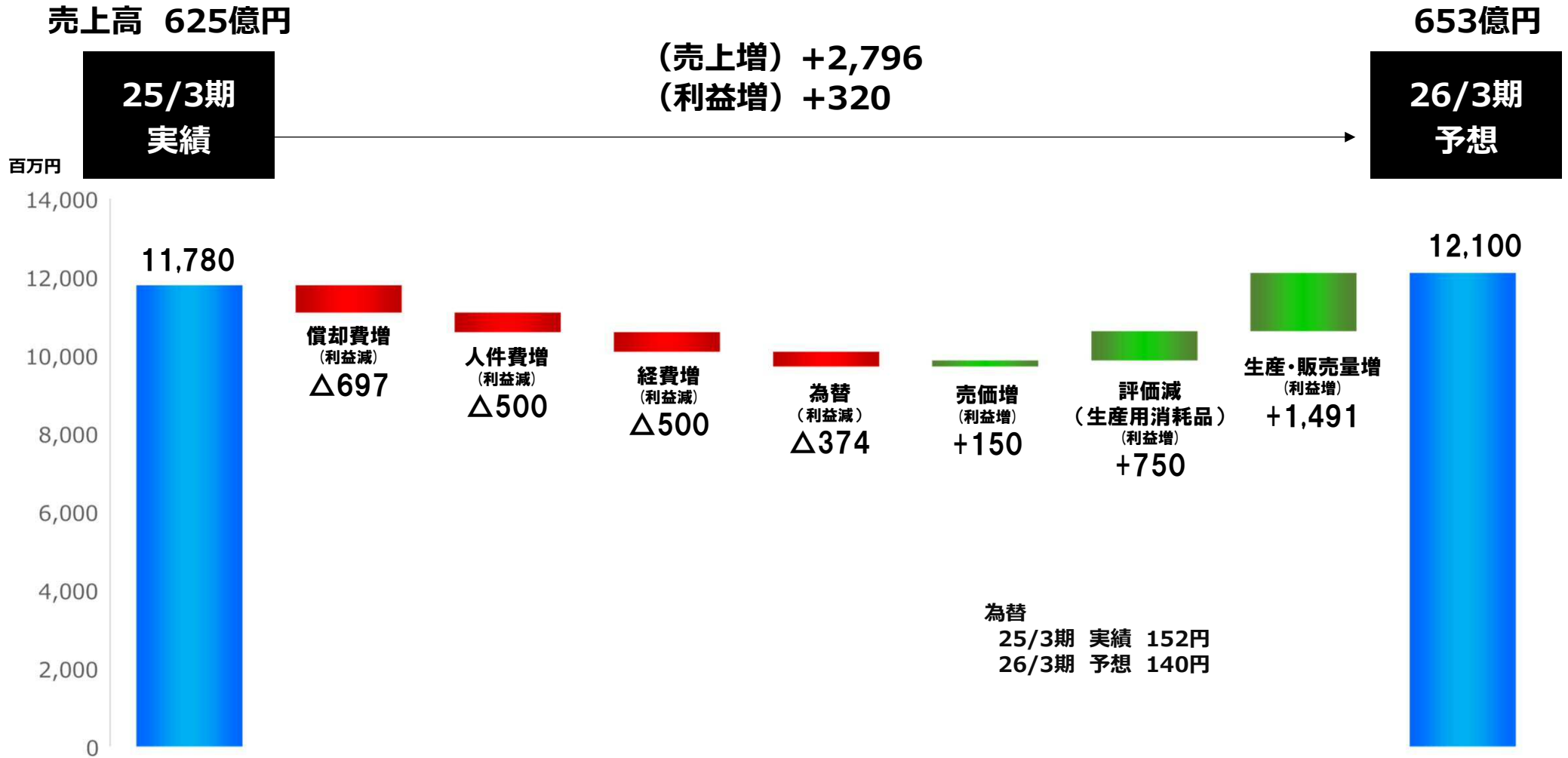


損益分析

営業利益増減要因 24/3期実績 → 25/3期実績



営業利益増減要因 25/3期通期実績 → 26/3期通期予想



株主還元

積極的な株主還元と安定配当の継続

■ 利益配分に関する基本方針

1. 連結配当性向 55%以上（2024年3月期より）
2. 安定配当の継続

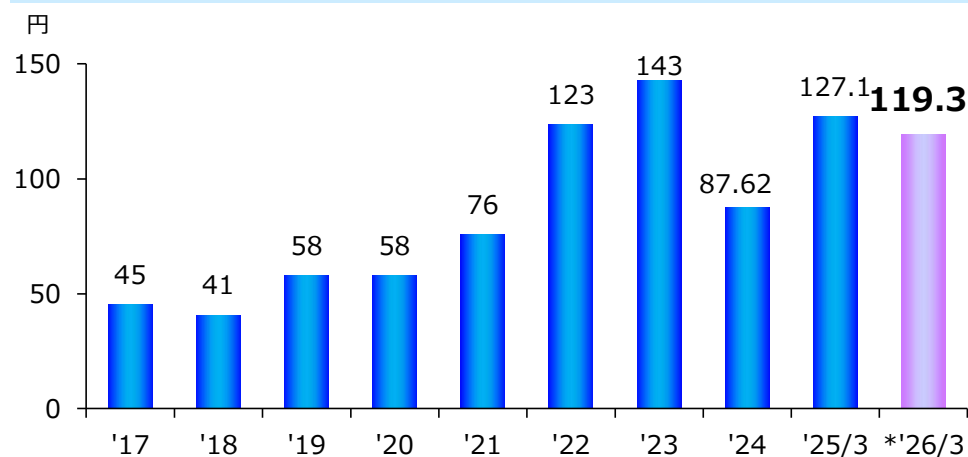
*DOEの配当指標への追加については検討継続

■ 1株当たり配当金 2026年3月期は配当維持

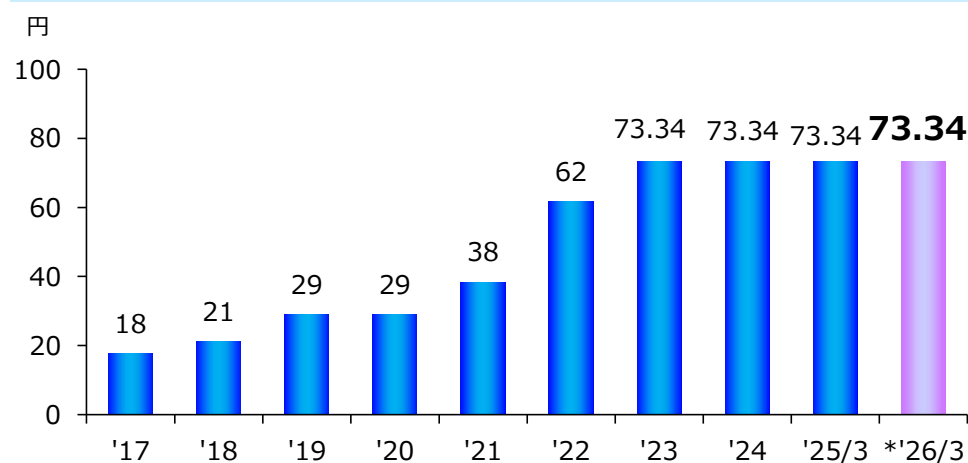
	2024/3月期				2025/3月期		2026/3月期
	期初予想		実績		期初予想	実績	期初予想
	2023/5/10		2024/5/13		2024/5/13	2025/5/13	2025/5/13
	3分割前	3分割後	3分割前	3分割後			
中間配当金	110.01円	36.67円	110.01円	36.67円	36.67円	36.67円	36.67円
期末配当金	110.01円	36.67円	110.01円	36.67円	36.67円	36.67円	36.67円
年間配当金	220.02円	73.34円	220.02円	73.34円	73.34円	73.34円	73.34円
配当性向	56.7%		83.7%		57.7%		61.5%
目標配当性向	55%以上				55%以上		55%以上

積極的な株主還元と安定配当の継続

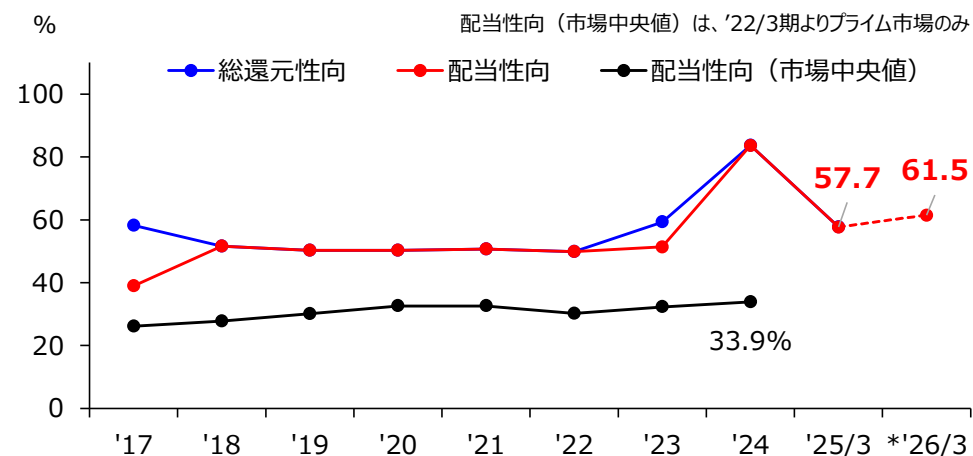
1 株当たり当期純利益



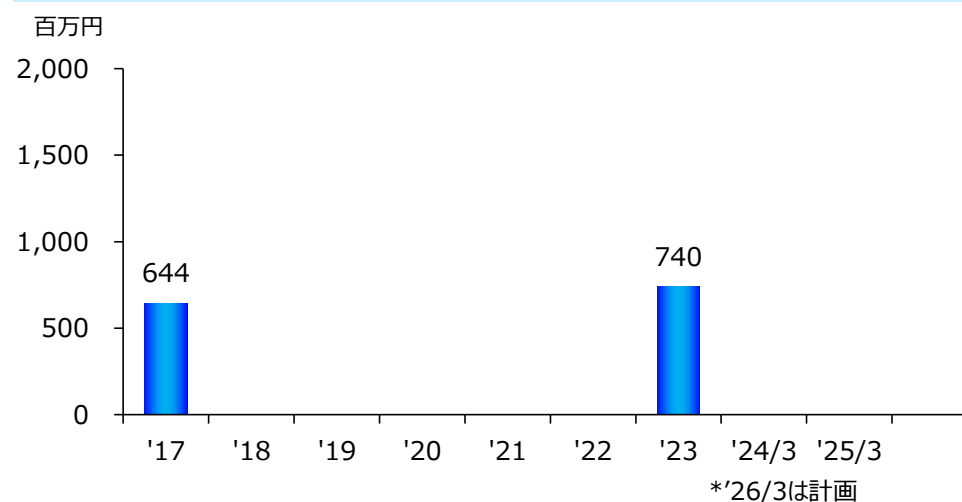
1 株当たり配当金



総還元性向・配当性向



自己株買い



2025年3月期 業績サマリー／2026年3月期 業績予想

* 1 当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益 * 2 EBITDA=営業利益+減価償却費

【2025年3月期 業績サマリー】

✓ 売上高	+21.5%	： 先端半導体向けCMP製品及びシリコンウェハー向け製品の販売が好調に推移し、増収増益
✓ 営業利益	+42.8%	：
✓ 経常利益	+36.8%	：
✓ 当期純利益*1	+45.1%	：
✓ シリコンウェハー向け	+31.3%	： シリコンウェハー生産回復に伴い増収（但し、ウェハー販売はCY25 1Q減少）
✓ CMP向け	+11.9%	： 先端ロジックデバイスやメモリ向けで増収
✓ ハードディスク向け	+84.1%	： データセンター向けHDDの需要増加を受け増収
✓ 一般工業用向け	+25.4%	： 自動車、産業機械、半導体製造装置向けで増収
✓ 株主還元		： 配当維持、配当性向 57.7%

【2026年3月期 業績予想】

✓ 売上高	+4.5%	： 半導体の生産の本格的な回復には依然時間を要すものの緩やかな回復を想定
✓ 営業利益	+2.7%	： 設備投資関連人員増及び償却開始等先行的な費用増を見込む
✓ 経常利益	△1.2%	： 配当収入・金利収入等あるも、工場建設のための資金調達関連費用を見込む
✓ 当期純利益*1	△6.1%	： 前期は賃上促進税制による税控除あり
✓ EBITDA*2	+7.4%	： 営業増益、償却費増を見込む

技術を磨き、心をつなぐ



FUJIMI INCORPORATED